

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	南方基金、富国基金、中银基金、长城基金、鹏华基金、博时基金、嘉实基金、金鹰基金、长盛基金、中加基金、民生加银、平安基金、建信基金、国寿安保、华宝基金、金信基金、兴银理财、长江资管、百嘉基金、阳光资产、太平资产、香港惠理、杭银理财、犁得尔投资、煜德投资、源峰基金、鑫元基金、合众资产、复星保德信、创金合信、大朴资产、同泰基金、青骊投资、兴业证券、长江证券、国泰海通、中金公司、国元证券、天风证券、华泰证券、华安证券、上海证券、中信证券、上海证券、西部证券、甬兴证券、方正证券、华福证券、国海证券、东莞证券、广发证券、浙商证券等65位投资者
时间	2025年10月30日 15:00-16:00 2025年10月31日 13:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事会秘书、财务总监 邱靖琳 2、投关经理 江正才

投资者关系活动主要内容介绍

公司基本情况介绍：

董事会秘书、财务总监邱靖琳女士详细介绍了公司发展的主营业务和研发创新情况。

公司与参会人员就以下问题进行了探讨：

1、2025 年三季度整体经营情况。

答：公司前三季度累计实现营业收入77,492.44万元，同比增长34.21%；归属于母公司股东的净利润12,125.70万元，同比增长175.35%；扣除非经常性损益的净利润11,585.37万元，同比增长199.57%。其中，第三季度单季营业收入32,130.63万元，同比增长47.40%；归属于母公司股东的净利润为5,411.50万元，同比大幅增长227.15%，单季收入与利润均创历史新高。

2、请简要介绍公司营业收入同比增长较快的原因

答：报告期内，公司营业收入实现增长，主要系锡膏印刷设备验收金额同比增加所致。

近年，下游电子制造行业中电子装联设备需求主要受到以下因素影响：

① 人工智能投资规模扩大：2025年全球 AI基础设施投资加速，带动AI服务器市场需求强劲增长，进而增加了对电子装联设备的需求。

② 消费电子需求回暖：IDC报告显示，2025年第三季度全球智能手机出货量同比增长2.6%，PC出货量同比增长9.4%。终端市场复苏拉动了PCBA(印制电路板组装)中SMT(表面贴装技术)环节的设备投资。

③ 新能源车渗透率提升：汽车电子化趋势持续，促进了SMT设备采购。

3、请问锡膏印刷设备需求高端化的原因

答：公司锡膏印刷设备需求呈现高端化趋势，主要基于技术迭代、成本效益和市场驱动三方面的因素，是电子制造产业升级的必然结果。

① 技术驱动：元器件小型化与工艺精度提升

下游电子产品，如AI服务器、高端手机的主板，其元器件尺寸持续小型化，集成度大幅提高。这要求锡膏印刷设备必须具备更高的定位精度和稳定性，以确保锡膏能精准印刷在微小的焊盘上，避免连锡、虚焊等缺陷。同时，产品基板

（PCB）层数更多、尺寸更大，在焊接中易变形，需要高端设备具备自动翘曲补偿等智能功能来保证质量。

② 成本驱动：高价值产品对良率要求极高

在AI服务器等领域，单块PCB板及其搭载的芯片价值量非常高。任何微小的印刷缺陷都可能导致整板报废，成本损失巨大。因此，客户对生产良率的要求高，愿意投资采购精度更高、稳定性更好、具备智能化辅助功能的高端设备，从根本上降低综合生产成本和质量风险。

③ 市场驱动：高端应用场景快速增长

根据IDC等市场研究机构数据，AI数据中心、先进封装、高端消费电子和汽车电子等高端市场正快速增长。这些应用场景对电子设备的可靠性和一致性有严苛要求，直接拉动了对高精度、智能化SMT制造设备的需求。高端锡膏印刷设备已成为保障这些高端电子产品量产能力和一致性的关键。

4、请问公司在手订单情况如何？

答：报告期末，公司合同负债规模创历史新高，后续业绩具备一定韧性。

5、公司在研发方面有哪些进展

答：2023年度、2024年度和2025年半年度研发投入分别为

	<p>7,446.01万元、7,812.78万元、4,149.59万元，占营业收入的比例分别为10.06%、9.12%、9.15%。研发费用的持续投入、完善的研发管理和较强的研发团队为公司形成体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势提供了重要保障，也为公司积累了大量技术成果。截至2025年6月30日，公司已取得专利285项，包括104项发明专利、176项实用新型专利和5项外观专利，此外还有30项软件著作权。</p> <p>6、请介绍一下刚刚完成授予的股权激励情况</p> <p>答：2025年10月16日，公司正式向69名核心技术人员授予了58.39万股限制性股票。这一激励举措与三季度强劲的业绩表现一脉相承，其核心逻辑在于：卓越的当下业绩，需要稳定的核心团队来延续；而前瞻性的激励机制，正是激发团队潜能、锁定未来增长的关键。这充分表明，公司正转化为通过制度化建设追求长期发展的坚定动力。</p> <p>7、电子装联下游应用情况</p> <p>答：根据QY Research行业报告，PCB下游应用中，消费电子占比33%，网络通信占比约20%，汽车电子占比约20%，医疗器械、家电等约占27%。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025年10月31日